



(証券コード: 4973)

2012年3月期 決算説明資料



決算の概況

(注)当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
- 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なので、売上高に大きく影響します。
- 弊社の業績を見るには、「売上総利益＝粗利」に注目してください。

2012年3月期 通期の概況

電子部品業界の状況

- スマートフォンやタブレット型PCに関連する半導体や電子部品の需要は旺盛であった。
- 7月からの欧米経済の失速や消費低迷を受けて、パソコン向け・液晶テレビ向けは、メーカーが過剰在庫リスク回避のため部品発注を抑制する傾向を強め、年間を通じて需要が低迷した。

当社決算の概況

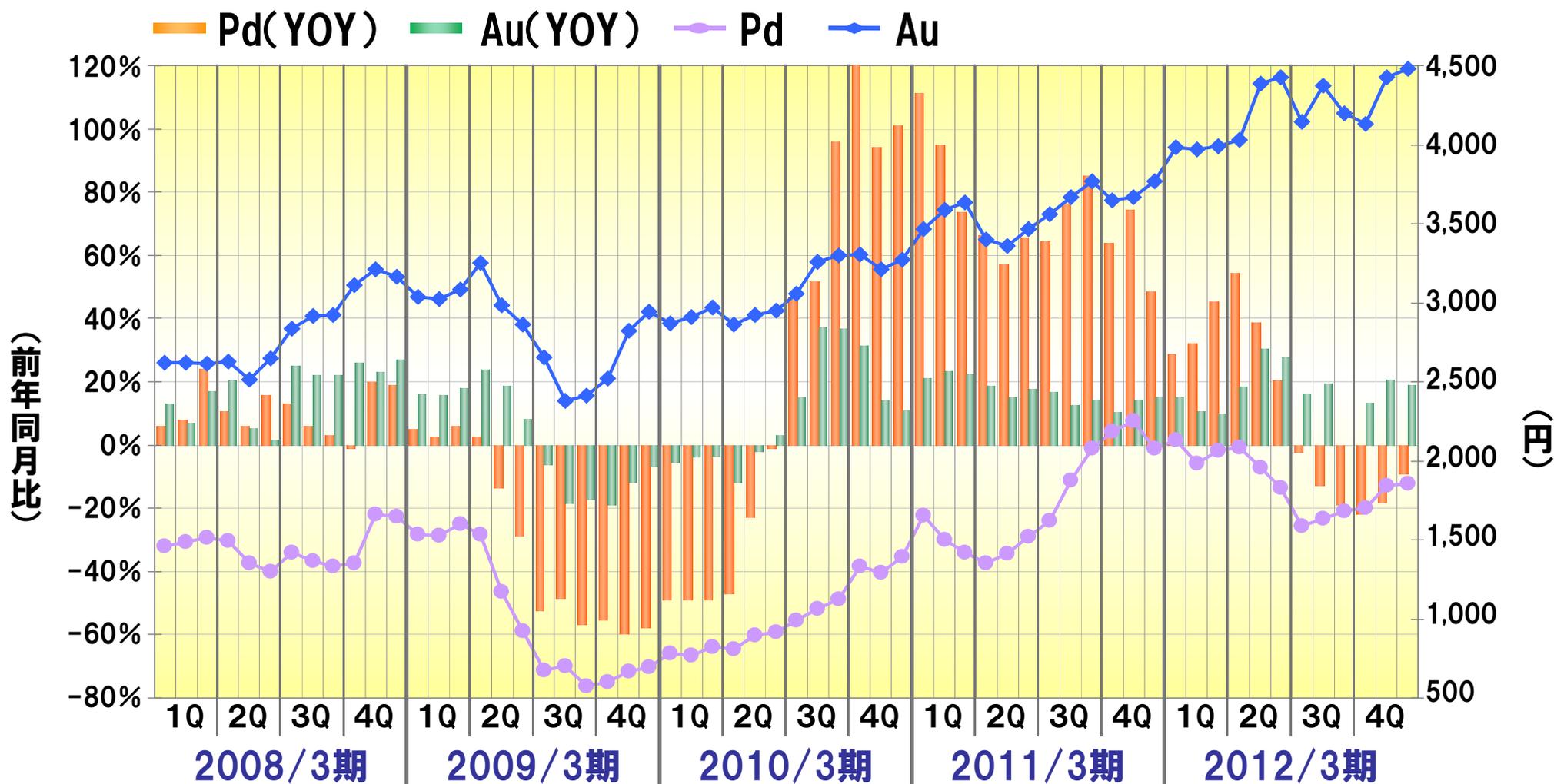
- **高付加価値製品は技術的な優位性と旺盛なニーズにより、堅調に推移**
 - 携帯電話用高精細コネクタ向け硬質金めっき薬品、鉛フリー対応リードフレーム向け電解パラジウムめっき薬品、スマートフォン用プリント基板やサーバーに搭載される半導体パッケージ基板向け無電解金めっき薬品の販売は堅調に推移。
- **既存製品は需要低迷とメーカーの節約志向の高まりにより、販売が低迷**
 - 従来からの半導体パッケージ基板やフレキシブル基板、コネクタ、リードフレームなどに適用される電解金めっきや電解パラジウムめっき用薬品の販売が低迷。

2012年3月期 決算概況

(単位:百万円、%)

決算期	2011/3期	2012/3期						2012/3期 修正業績予想 (2012/2/17発表)	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計		達成率	
						増減率			
売上高	10,553	2,627	2,657	2,089	2,347	9,721	△7.9	9,350	104.0
営業利益	1,455	366	334	261	299	1,260	△13.4	1,160	108.6
経常利益	1,497	392	338	280	297	1,309	△12.6	1,210	108.2
純利益	885	232	118	152	194	697	△21.2	620	112.6
1株当たり 当期純利益	14,389.03	3,776.85	1,924.77	2,499.92	3,081.91	11,437.16	△20.5	10,301.91	111.0

金 (Au) およびパラジウム (Pd) の市況

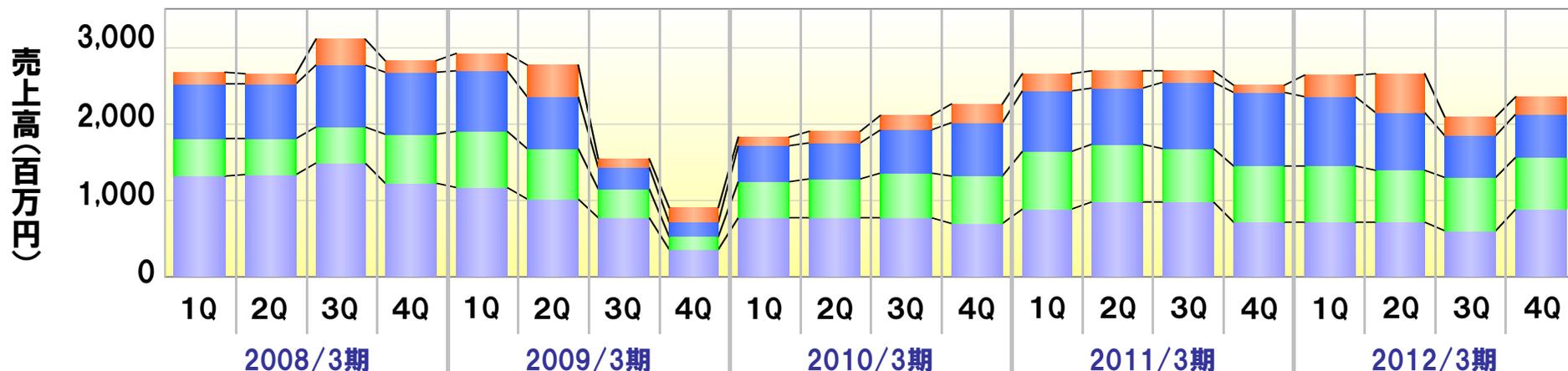


- 第4四半期の金価格は、前年同期比約18%上昇、パラジウム価格は同約17%下落
- 年間平均の金価格は、前年比約18%上昇、パラジウム価格は同約8%上昇

用途品目別および地域別売上高の推移

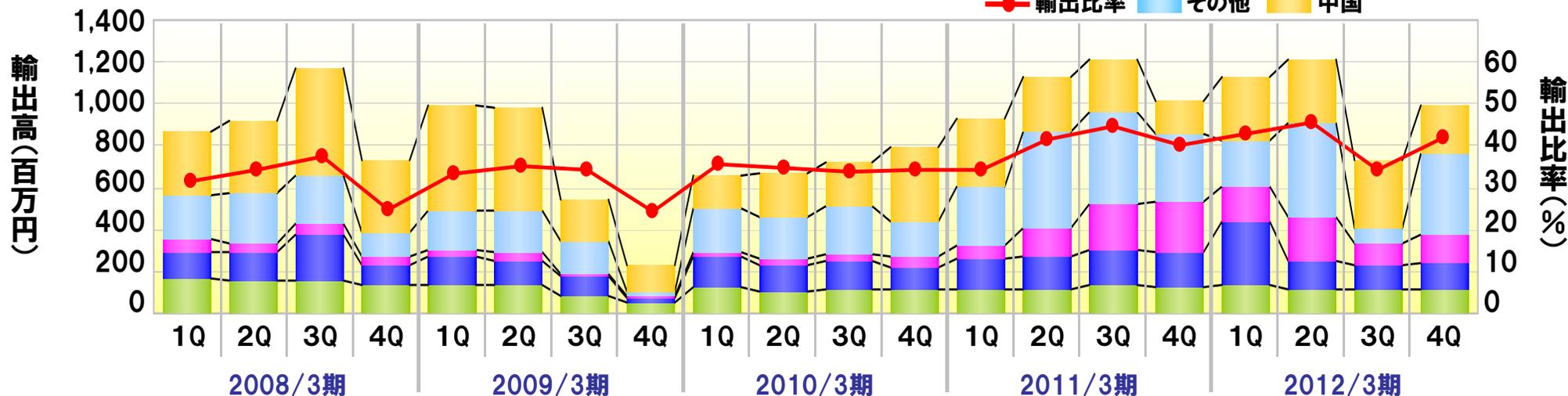
用途品目別売上高の推移

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクタ・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他

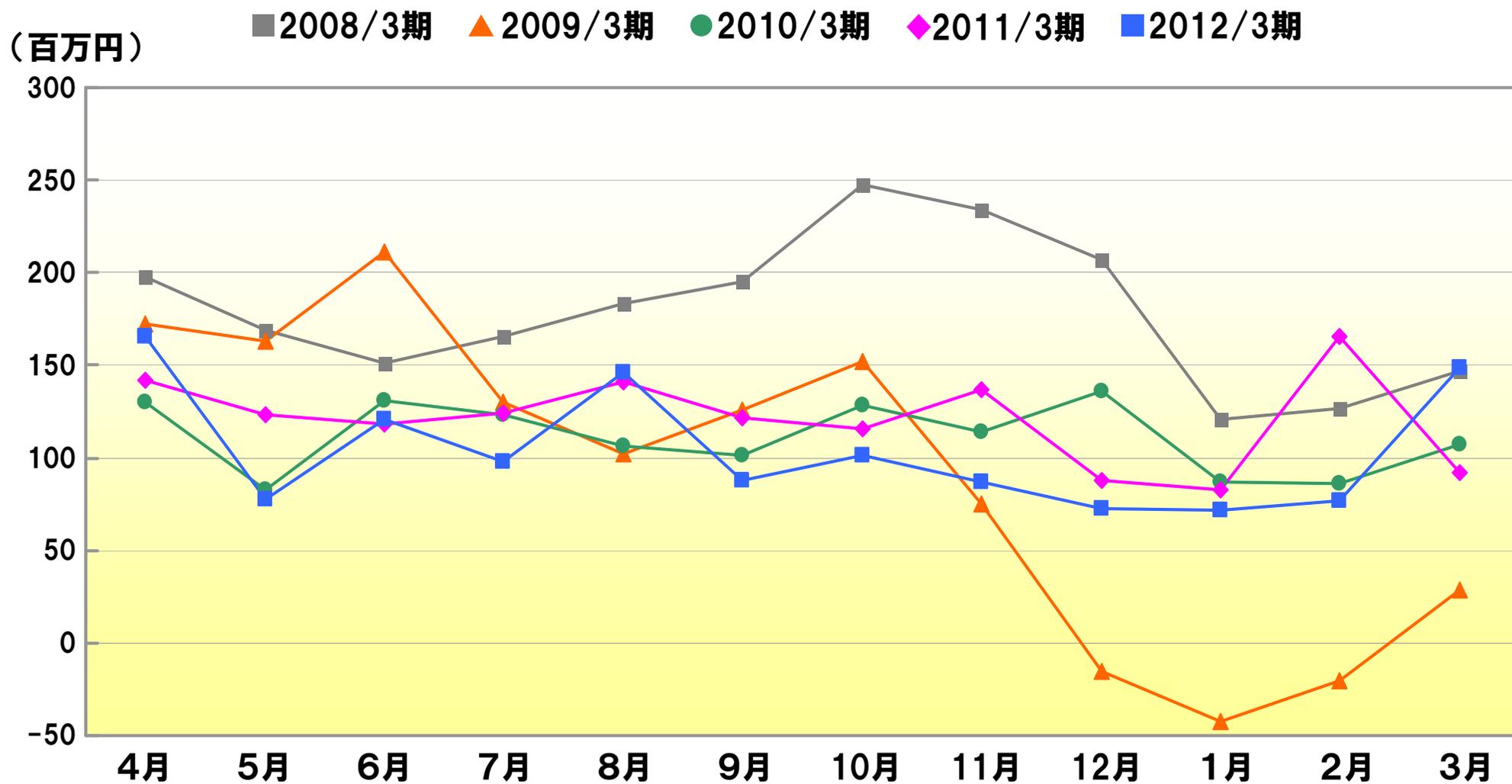


地域別(輸出)売上高の推移

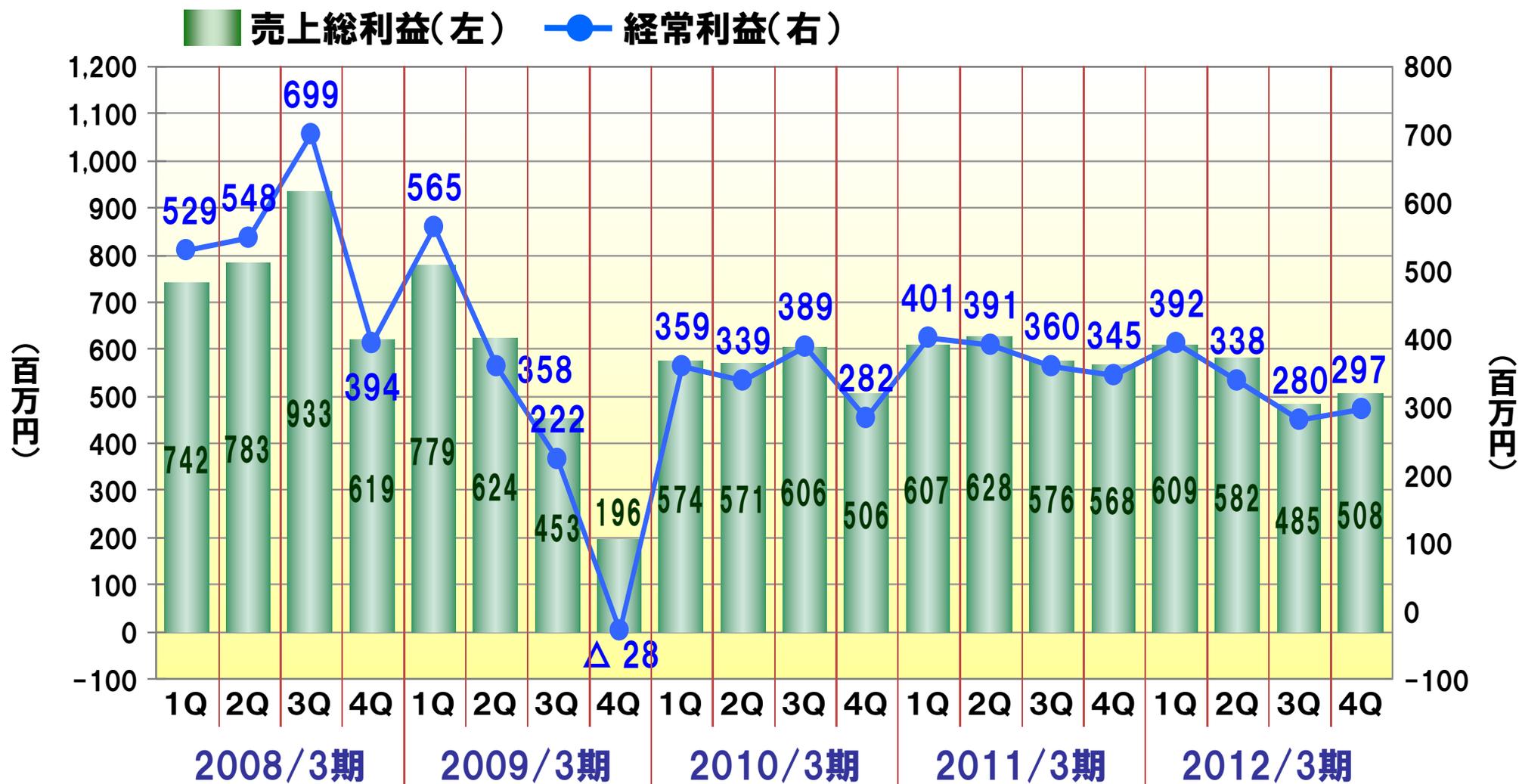
- 台湾
- 韓国
- シンガポール・マレーシア
- 輸出比率
- その他
- 中国



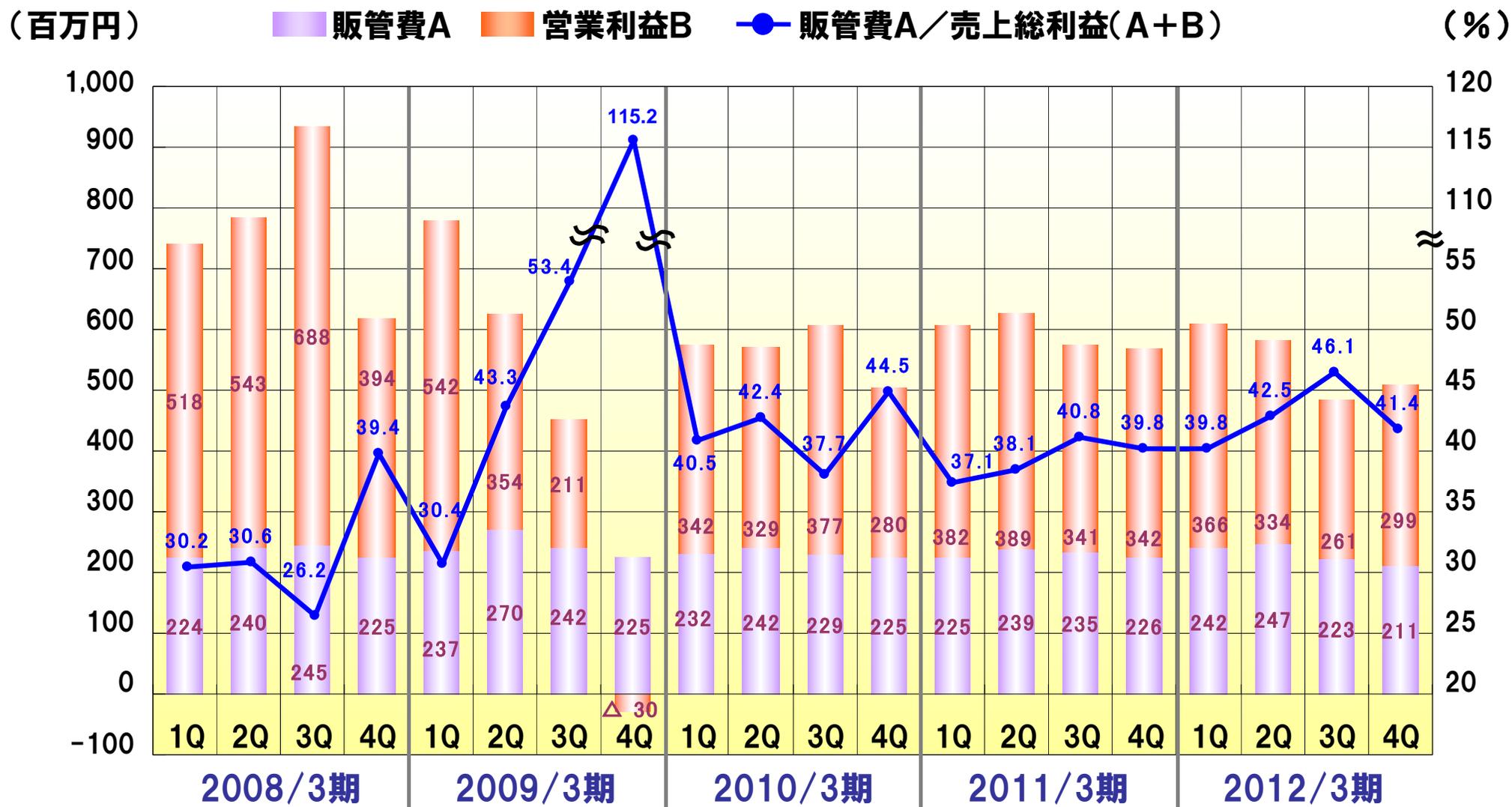
営業利益の推移(5ヶ年)



売上総利益および経常利益の推移



販売管理費および営業利益の推移



株主還元について

■一株当たり配当金

(単位:円、%)

	中間	期末	通期	EPS	配当性向
2008/3期	4,000	4,000	8,000	20,459	39.1
2009/3期	4,000	4,000	8,000	6,453	124.0
2010/3期	4,000	4,000	8,000	13,081	61.2
2011/3期	4,000	4,000	8,000	14,389	55.6
2012/3期	4,000	4,000	8,000	11,437	70.0

総株主還元性向

(2012年3月期)

自社株式購入総額

282百万円

配当総額

492百万円

総株主還元性向

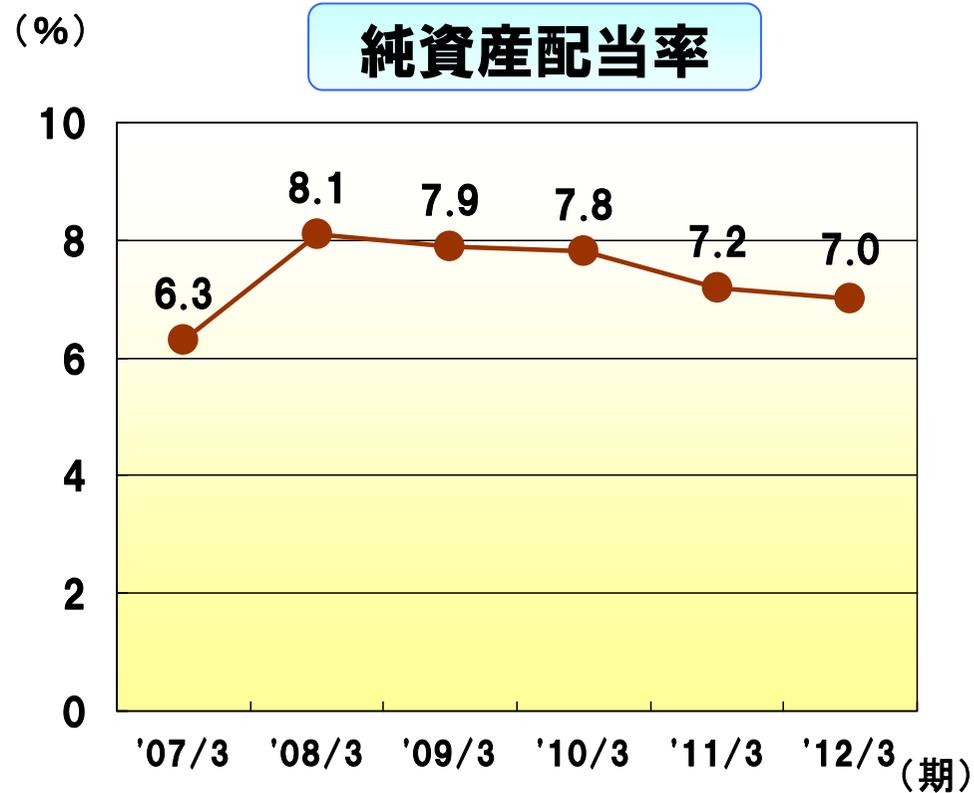
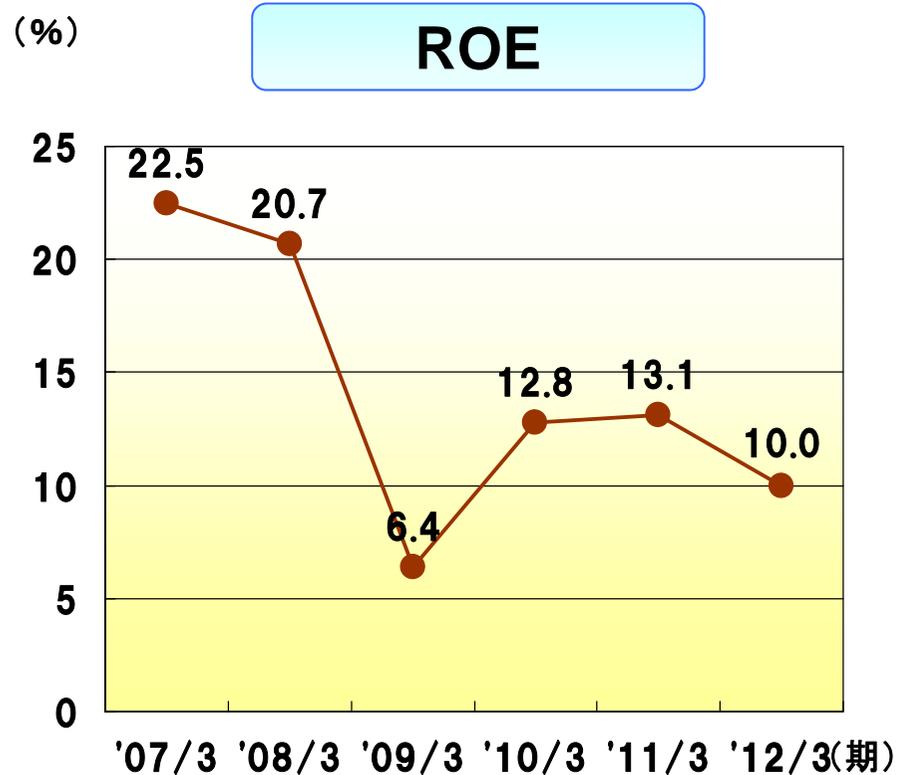
111.0%

2013年3月期 業績見通し

(単位:百万円、%)

決 算 期	2012/3期 第2四半期	2012/3期 通期	2013/3期 第2四半期		2013/3期 通期	
	実績	実績	予想	前年比	予想	前年比
売 上 高	5,284	9,721	5,050	△4.4	10,100	3.9
営 業 利 益	701	1,260	620	△11.6	1,270	0.8
経 常 利 益	730	1,309	644	△11.7	1,310	0.1
当 期 純 利 益	350	697	427	21.7	840	20.3
1株当たり当期純利益	5,701.62円	11,054.18円	6,760.82円	18.6	13,950.94円	22.0

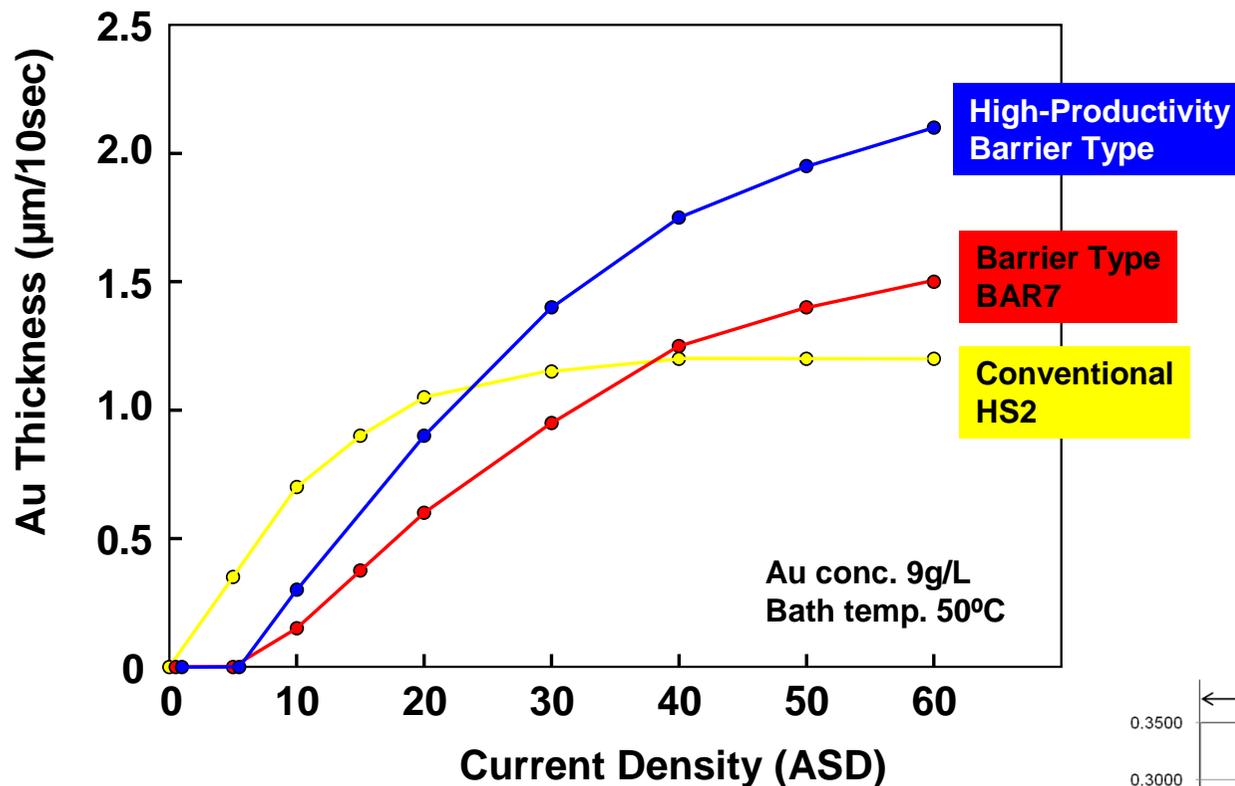
重視する経営指標



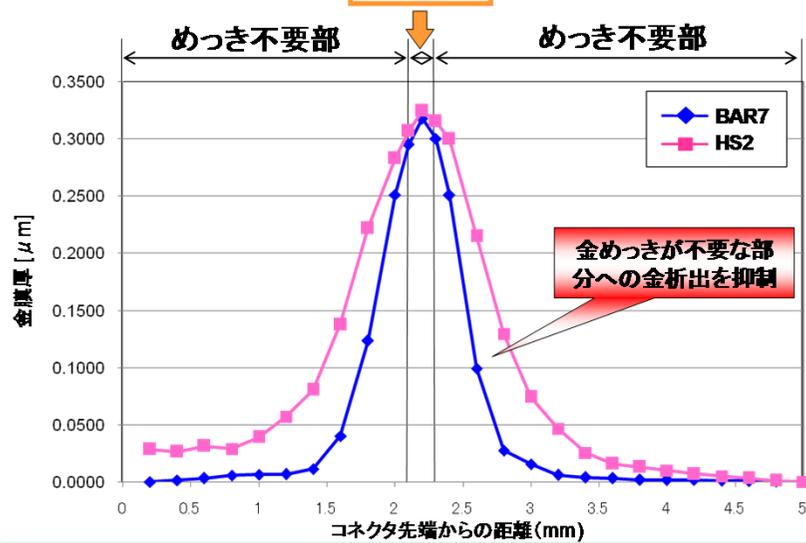
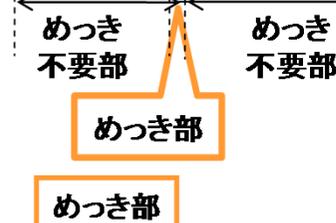
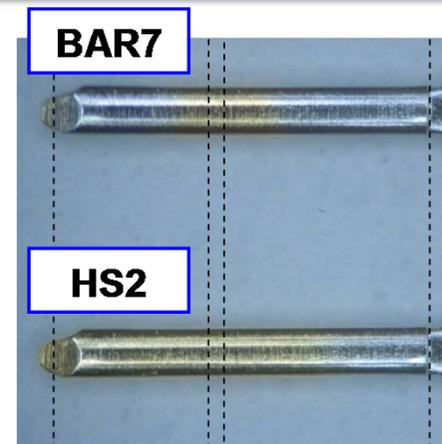


研究開発トピックス

新製品(BAR7)の改良：高速化 BAR7X

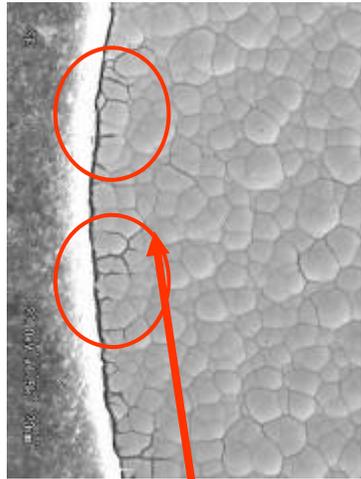
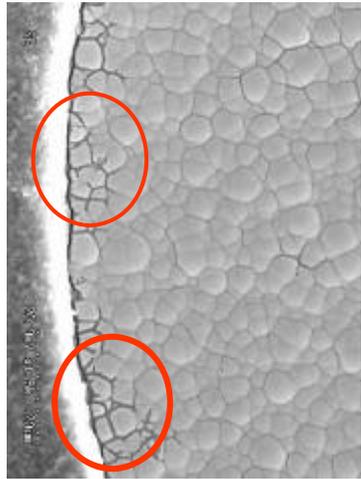
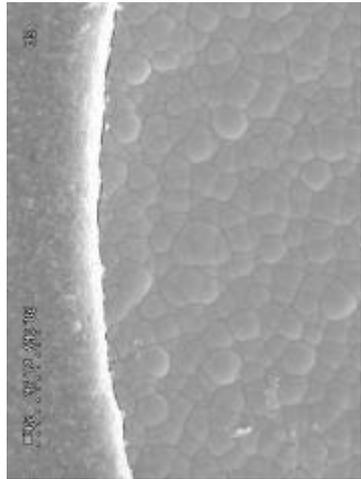
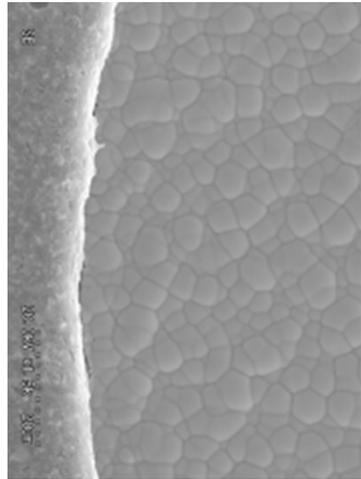


低電流領域では析出抑制、
高電流領域では析出促進



新製品(IM-GOLD)の改良：省金置換金 OM

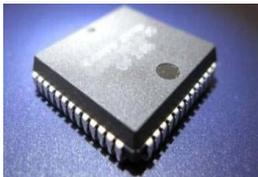
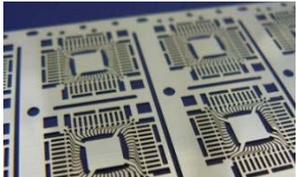
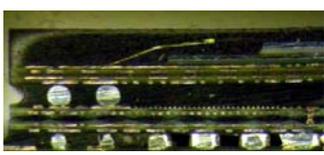
金濃度を低下させてもNi-P表面の局所腐食が起きないめっき浴

Au 浴	従来浴	従来浴	OM	OM
Au 濃度	2g/L	1g/L	1g/L	0.5g/L
下地Ni-P	市販Ni-P浴	市販Ni-P浴	市販Ni-P浴	市販Ni-P浴
SEM				

Au濃度が低下すると
局所腐食発生

OM 浴は 0.2g/Lまで低減しても
腐食発生せず

めっき方式と将来の新製品

めっき方式		用途		新製品および将来上市品
電解	純金 (99.99%以上)			TEMPERESISTシリーズ ICパッケージのワイヤーボンド接続用 省金 <input type="text"/>
	硬質金 (金Co合金)			OROBRIGHTシリーズ コネクタなどのコンタクト接続用 マイクロコネクタ BAR7
	電解Pd			PALLABRIGHTシリーズ リードフレームへの応用。 PPF薄膜化 NANO2
無電解	置換金			IM-GOLDシリーズ 携帯基板のACF接続、はんだ接続用 スマートフォン基板 IB2 IB2X OM
	還元金			NEOGOLDシリーズ サーバーやデスクトップPC用 MPUパッケージ NEOGOLD-PN
	還元Pd			NEOPALLABRIGHTシリーズ スマートフォン用 SiPパッケージ 新機能 <input type="text"/>

注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2012年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画室

管理部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>